

보도시점 2026.10.27.(화) 16:00 배포 2026.10.27.(화) 08:30

'R&D부터 수출까지' K-방산, 지식재산으로 지킨다!

- 지재처·방사청, '방산기업의 IP 분쟁대응 체계 구축·국방R&D 성과 활용 MOU' 체결 -

지식재산처(처장 김용선)는 방위사업청(청장 이용철)과 10. 27.(화) 15시 한국 지식재산센터(서울 강남구)에서 '방산기업의 지식재산(IP) 분쟁대응 체계 구축 및 국방R&D 성과 활용을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 밝혔다.

전 세계 국방비 규모는 연간 3조 달러 이상이고, 국내 방산 수출규모도 지속 증가*하고 있는 추세다. 아울러 국방R&D로 개발된 기술은 민간 산업에도 활용 가능한 민군겸용기술(Dual-use technology)로서 가치가 확대되고 있으며, 국방기술거래장터**에는 기계, 전기·전자, 정보·통신 분야 등 약 4,000건의 국방특허기술이 등록되어 있다.

* 방산 수출 수주액 (US 달러): ('23) 135억 → ('24) 95억 → ('25) 154억 ('26, 산업연구원)

** 국방과학연구소(ADD) 등이 개발한 국방기술을 민간에 이전·상용화하는 공식 온라인 플랫폼

반면, 수출과 기술이전, 해외 현지 협력 과정에서 핵심 방산기술 유출, 특허·영업비밀 침해 및 분쟁 등의 위험요소도 함께 증가하고 있다. 첨단 국방 R&D 투자가 확대되는 만큼, 국방과학기술을 지식재산으로 확보·보호하고 우리 방산기업이 해외시장에서 직면할 수 있는 분쟁에 효과적으로 대응할 필요성이 커지고 있다.

이번 협약은 양 기관의 정책과 지원사업을 연계하여 국방R&D부터 민간 활용, 해외진출에 이르기까지 방산기술을 지식재산으로 보호하기 위해 마련되었다. 구체적인 협력 분야는 ▲국방·방산 분야 지식재산 분쟁 및 기술 유출 예방·대응 ▲지원사업 연계 ▲방산기업 대상 지식재산 교육·상담 ▲해외 지식재산 정보 제공·공유 ▲국방R&D 지식재산 창출·관리·활용 강화 ▲방산기술 보호·관리 분야 전문인력 및 특허분석 지원 등이다.

이용철 방위사업청장은 “첨단 국방기술의 경쟁력이 곧 방위산업의 경쟁력으로 이어지는 만큼 우수한 기술을 개발하는 것뿐만 아니라 이를 지식재산으로 확보하고 체계적으로 보호·활용하는 것이 중요하다”며 “이번 협약을 계기로 지식재산처의 전문성과 방위사업청의 국방R&D·방산기업 지원체계를 긴밀히 연계하여 우리 기업들이 국내외 시장에서 안정적으로 경쟁할 수 있는 기반을 강화하겠다”고 말했다.

김용선 지식재산처장은 “기술유출 및 특허분쟁은 한 번 발생하면 수출계약과 일정 전반에 영향을 미치는 등 기업의 사활이 걸린 문제인 만큼 사전에 대비하는 것이 무엇보다 중요하다”며 “지식재산처가 축적해 온 IP 전문 역량을 방산 분야와 연계하여, 우리 방산기업이 R&D부터 수출까지 지식재산 걱정 없이 경쟁할 수 있도록 뒷받침하겠다”고 밝혔다.

※ 붙임: MOU 체결식 개요/ 사진은 행사 후 배포

담당부서	지식재산처 지식재산분쟁대응국 특허분쟁대응과	책임자	과 장	최진호 (042-481-5182)
		담당자	주무관	황태현 (042-481-8210)
	방위사업청 국방기술개발보호국 기술정책과	책임자	과 장	김현욱 (02-2079-6380)
		담당자	사무관	김석준 (02-2079-6386)





1 추진 배경

- 방산 수출 확대에 따라 해외 특허분쟁 대응 및 핵심기술 보호와 함께 국방R&D 성과를 지식재산으로 체계적으로 활용할 필요성 증대

2 행사 개요

- (일시·장소) '26. 10. 27.(화), 15:00~15:20 / 지재처 서울사무소 5층 대회의실
- (참석자)
 - (지재처) 처장, 지식재산분쟁대응국장, 특허분쟁대응과장
 - (방사청) 청장, 국방기술개발보호국장, 기술정책과장
- (주요내용)
 - 방산 분야 지식재산 분쟁 및 기술유출 예방·대응
 - 방위산업 지원정책과 지식재산 지원정책 유관 사업간 연계 협력
 - 해외진출 방산기업 대상 지식재산 교육·상담 및 영업비밀 보호 지원
 - 해외 지식재산 분쟁·동향 등 관련 정보의 공유 및 활용
 - 국방R&D 성과의 지식재산 창출·보호·활용 강화
 - 방산기술 보호·관리를 위한 지식재산 전문인력 및 특허분석 지원

3 진행 순서

시 간		주요 내용	비고
15:00 ~ 15:05	5'	• 개회 및 인사말씀	5층 대회의실
15:05 ~ 15:15	10'	• MOU 서명 및 기념 촬영	
15:15 ~ 15:20	5'	• 행사 마무리	